

300MHB-3000 数显布氏硬度计



主要特点:

- 电子加力，全自动闭环压力传感器控制系统，试验力精度高，稳定性好；
- 采用 ARM 高速处理器，8 寸液晶触摸屏；
- 配机下数显测微计，数显测微计通过数据接口与主机相联，在机下测量压痕直径，液晶屏直接显示硬度值，不用手动输入压痕直径数值，操作方便；
- 结构坚固、刚性好、可靠、耐用、测试效率高；
- 12 种试验标尺；10 级试验力，力值范围：62.5kgf-3000kgf；
- 试验力施加-保持-卸除全自动，加卸荷过程动态显示时间-力值曲线；
- 中英文界面转换；各种硬度值转换；
- 屏幕上能显示试验力、压痕长度、保荷时间、测量次数等；
- 具备数据库存储数据功能，测试数据同步存储并可导出；
- 配 USB 和 RS232 接口，方便用户进行数据处理；
- 可选配微型打印机，直接打印测试结果；
- 精度符合 GB/T231.2、ISO6506-2 和美国 ASTM E10。

应用范围：

- 测定黑色金属、有色金属等材料的布氏硬度；
- 测定铅基合金、巴氏合金、锡铋合金等轴承合金材料的布氏硬度；
- 测定硬质塑料、电木等某些非金属材料的布氏硬度；
- 测定采用铸造、锻造、轧制等工艺生产零件的布氏硬度。

技术参数：

- 测量范围：4-650HBW
- 试验力：612.9、980.7、1226、1839、2452、4903.5、7355、9807、14710.5、29421 (N)
62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000 (kgf)
- 测量标尺：HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、
HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000
- 试样允许最大高度：280mm
- 压头中心至机壁距离：150mm
- 电源：AC220V，50/60Hz
- 外形尺寸：570x330x910 (mm)
- 重量：约 160kg

主要附件：

- 大平试台：1 个
- 小平试台：1 个
- V 型工作台：1 个
- 碳化钨球压头：Φ10、Φ5、Φ2.5mm 各 1 个
- 标准布氏硬度块：2 块
- 20X 数显测微计：1 架

可选附件：

- 长方形大平工作台：400x150x30 (mm)
-